



Kc A-Dng
Thư

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

THƯ MỜI

Viết bài tham dự Hội thảo quốc tế về tích hợp hệ thống IEEE/SICE SII 2024

Kính gửi:..... Ban Giám hiệu.....

..... Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.....



Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và người học của Quý Trường/Viện nghiên cứu/Cơ quan viết bài tham dự Hội thảo quốc tế về tích hợp hệ thống lần thứ 16 có tên tiếng Anh là *The 2024 IEEE/SICE International Symposium on System Integration, viết tắt là IEEE/SICE SII 2024, được tổ chức ngày 08-11/01/2024 tại Vinpearl Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.*

Đây là Hội thảo có uy tín nhất trên thế giới của các kỹ sư, các nhà nghiên cứu, sản xuất, cũng như sinh viên của các khối ngành kỹ thuật trong lĩnh vực tích hợp hệ thống, được đồng tổ chức bởi IEEE (Hội kỹ sư điện và điện tử quốc tế) và SICE (Hội kỹ sư đo đạc và điều khiển tự động Nhật Bản). Hàng năm, hội thảo thu hút hơn 250 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới tới trình bày, trao đổi các khía cạnh mới nhất và có tính tương lai về tích hợp hệ thống, tích hợp phần cứng/phần mềm, tự động hóa và robot. *Tất cả bài báo được chọn tham dự, trình bày tại Hội nghị sẽ được xuất bản trên IEEE explore, được chỉ mục trong cơ sở dữ liệu Web of Science, Scopus.*

Với mong muốn đưa hội thảo quốc tế về Việt Nam, các nhà khoa học người Việt đang là giáo sư tại các trường Đại học uy tín trên thế giới (*trong thành phần 100 trí thức Việt về Việt Nam tham dự kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức*) đã đề nghị thành công ban điều hành IEEE/SICE SII cho phép tổ chức hội thảo IEEE/SICE SII lần thứ 16 tại Việt Nam và do *Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội* **dăng cai tổ chức**. Đây là vinh dự rất lớn cho cộng đồng nghiên cứu về tích hợp hệ thống và robot tại Việt Nam khi đã đưa được về nước một diễn đàn uy tín, kích thích sự chú ý về khoa học và kỹ thuật từ xã hội, cũng như tạo cơ hội khuyến khích các nhà nghiên cứu trong nước tham gia trao đổi học





thuật với các nhà nghiên cứu đến từ các nước có nền khoa học và kỹ thuật tiên tiến trên thế giới.

Một số mốc thời gian của IEEE/SICE SII-2024 như sau:

- Hạn nộp bài: 01/08/2023
- Thông báo chấp nhận: 01/10/2023
- Nộp camera-ready: 15/10/2023
- Thời gian Hội thảo: 08-11/01/2024

Ban tổ chức Hội thảo dự kiến có kinh phí hỗ trợ các tác giả trong nước nộp bài tham dự Hội nghị.

Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ:

- PGS.TS Bùi Thanh Tùng, Phó Chủ nhiệm khoa Điện tử - Viễn thông,
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Điện thoại: **0388698119**, Email: tungbt@vnu.edu.vn

- Website Hội nghị: <https://sice-si.org/SII2024/index.html>

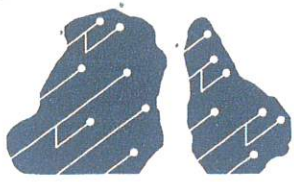
Trường Đại học Công nghệ gửi kèm công văn này thông báo mời nộp bài, trân trọng đề nghị Quý Trường/Viện nghiên cứu/Cơ quan phổ biến và khuyến khích, tạo điều kiện để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và người học trong đơn vị để chuẩn bị bài viết tham dự Hội thảo.

Trân trọng cảm ơn./.

HIỆU TRƯỞNG


Chữ Đức Trình





IEEE/SICE SII 2024

International Symposium on System Integration
HA LONG, VIETNAM 8-11th January, 2024



Ha Long Bay

IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII) is the symposium series presenting the state of the art and future perspectives of system integration, where industrial experts, researchers, and academics share ideas and experiences surrounding frontier technologies, breakthrough and innovative solutions, and applications.

The IEEE/SICE SII 2024 will be the 16th symposium on system integration. System integration is one of the key technologies and the integration of hardware and software is especially important to solve the industrial or social system problems in the new century. This symposium focuses towards new research and industrial applications of system integration, and discusses approaches and methodologies to improve effectiveness of system integration.

Important Dates:

Proposals for Special Sessions	Jun. 30, 2023
Paper Submission	Aug. 1, 2023
Workshop Proposal Submission Deadline	Aug. 15, 2023
Notification of Workshop Proposal Acceptance	Sep. 15, 2023
Notification of Paper Acceptance	Oct. 1, 2023
Final Paper Submission	Oct. 15, 2023
Late Breaking Results Submission	Oct. 15, 2023
Notification of Late Breaking Results Acceptance	Oct. 29, 2023



FOLLOW US !



@SII2024_HaLong

Contact: sii2024@ml.jaist.ac.jp

※ All proceedings will be published on IEEE Xplore, and indexed by Web of Science and Scopus.

Host University



General Chair
Van Anh Ho, Japan Advanced Institute of Science and Technology, Japan.

General Co-chair
Gordon Cheng, The Technical University of Munich, Germany.
Jun Ueda, Georgia Institute of Technology, United States.

Program Chair
Trung Dung Ngo, University of Prince Edward Island, Canada.

Program Co-Chairs
Hung (Jim) La, University of Nevada, United States.
Mochiyama Hiromi, University of Tsukuba, Japan.
Matteo Bianchi, University of Pisa, Italy.

Special Sessions Chairs
Mihoko Niitsuma, Chuo University, Japan.

Yonghoon Ji, Japan Advanced Institute of Science and Technology, Japan.

Workshop Chair
Zhongkui Wang, Ritsumeikan Univ, Japan

Publication Chairs
Thanh Nho Do, The University of New South Wales, Australia.
Yongsheng Ou, Chinese Academy of Sciences.

Industry Chair
Soti Tong, Siemens, Belgium.

Publicity Chair
Amy Kyungwon Han, Seoul National University, Korea

Local Arrangement
Thanh Tung Bui, VNU University of Engineering and Technology, Vietnam.

Financial Chairs

Pham Hung, VNU University of Engineering and Technology, Vietnam.
Dinh Quang Nguyen, Hanoi University of Industry, Vietnam.

Regional Chairs
Kumeresan A. D., University of Technology Malaysia, Malaysia.
Wee Hong Ong, Universiti Brunei Darussalam, Brunei.
John-Josef Leth, Aalborg University, Denmark.
Muhammad Iqbal, Tampere University, Finland.
Paikpong CHIRARATTANANON, City University of Hong Kong, China.
Lum Guo Zhan, Nanyang Technological University, Singapore.
Zhu Jian, Chinese University of Hong Kong, China

Administrative Support Members
Nhan Huu Nguyen, Japan Advanced Institute of Science and Technology, Japan.
Dinh Minh Nhat Le, Japan Advanced Institute of Science and Technology, Japan.

Photo credit: Thanh Chung